1 目的

希望以简短的篇幅,将公司目前设计的流程做介绍,若有介绍不当之处,请不吝指教.

- 2 设计步骤:
 - 2.1 绘线路图、PCB Layout.
 - 2.2 变压器计算.
 - 2.3 零件选用.
 - 2.4 设计验证.
- 3 设计流程介绍(以 DA-14B33 为例):
 - 3.1 线路图、PCB Layout 请参考资识库中说明.
 - 3.2 变压器计算:

变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的,以下即就 DA-14B33 变压器做介绍.

3.2.1 决定变压器的材质及尺寸:

依据变压器计算公式

$$B(\max) = \frac{LpxIp}{NpxAe}x100 \ Gauss$$

- ➤ B(max) = 铁心饱合的磁通密度(Gauss)
- ▶ Lp = 一次侧电感值(uH)
- ▶ Ip = 一次侧峰值电流(A)
- ▶ Np = 一次侧(主线圈)圈数
- ➤ Ae = 铁心截面积(cm²)
- B(max) 依铁心的材质及本身的温度来决定,以 TDK Ferrite Core PC40 为例,100℃时的 B(max)为 3900 Gauss,设计时应考虑零件误差,所以一般取 3000~3500 Gauss 之间,若所设计的 power 为 Adapter(有外壳)则应取 3000 Gauss 左右,以避免铁心因高温而饱合,一般而言铁心的尺寸越大, Ae 越高,所以可以做较大瓦数的 Power。
- 3.2.2 决定一次侧滤波电容:

滤波电容的决定,可以决定电容器上的 Vin(min),滤波电容越大, Vin(win)越高,可以做较大瓦数的 Power,但相对价格亦较高。

3.2.3 决定变压器线径及线数:

当变压器决定后,变压器的Bobbin即可决定,依据Bobbin的槽宽,可决定变压器的线径及线数,亦可计算出线径的电流密度,电流密度一般以 6A/mm²为参考,电流密度对变压器的设计而言,只能当做参考值,最终应以温升记录为准。

3.2.4 决定 Duty cycle (工作周期):

由以下公式可决定 Duty cycle ,Duty cycle 的设计一般以 50%为基准,Duty cycle 若超过 50%易导致振荡的发生。

$$\frac{Ns}{Np} = \frac{(Vo + V_D)x(1 - D)}{Vin(\min)xD}$$

- ➤ N_S = 二次侧圈数
- ▶ N_P = 一次侧圈数
- ▶ Vo = 输出电压
- ▶ V_D= 二极管顺向电压
- ▶ Vin(min) = 滤波电容上的谷点电压
- ➤ D = 工作周期(Duty cycle)
- 3.2.5 决定 Ip 值:

$$Ip = Iav + \frac{1}{2}\Delta I$$
 $Iav = \frac{Pout}{Vin(\min)xDx\eta}$ $\Delta I = \frac{Vin(\min)}{Lp}x\frac{P}{f}$

- ▶ Ip = 一次侧峰值电流
- ➤ Iav = 一次侧平均电流
- ➤ Pout = 输出瓦数
- η = 效率
- ightharpoonup f = PWM 震荡频率
- 3.2.6 决定辅助电源的圈数:

依据变压器的圈比关系, 可决定辅助电源的圈数及电压。

3.2.7 决定 MOSFET 及二次侧二极管的 Stress(应力):

依据变压器的圈比关系,可以初步计算出变压器的应力(Stress)是否符合选用零件的规格,计算时以输入电压 264V(电容器上为 380V)为基准。

3.2.8 其它:

若输出电压为 5V 以下,且必须使用 TL431 而非 TL432 时,须考虑多一组绕组提供 Photo coupler 及 TL431 使用。

3.2.9 将所得资料代入 $B(\max) = \frac{LpxIp}{NpxAe}x100~Gauss$ 公式中,如此可得出 $B(\max)$,若 $B(\max)$ 值太高或太低则参数必须重新调整。

3.2.10 DA-14B33 变压器计算:

◆输出瓦数 13.2W(3.3V/4A), Core = EI-28, 可绕面积(槽宽)=10mm, Margin Tape = 2.8mm(每边), 剩余可绕面积=4.4mm.

令假设 f_T = 45 KHz ,Vin(min)=90V, η =0.7,P.F.=0.5(cos θ),Lp=1600 Uh

- ♦ 计算式:
 - 变压器材质及尺寸:
 - ◆ 由以上假设可知材质为PC-40,尺寸=EI-28, Ae=0.86cm²,可绕面积(槽宽)=10mm, 因Margin Tape使用 2.8mm,所以剩余可绕面积为 4.4mm.
 - ◆ 假设滤波电容使用 47uF/400V, Vin(min)暂定 90V。
 - 决定变压器的线径及线数:

$$Iin = \frac{Pout}{Vin(\min)x\eta x \cos\theta} = \frac{13.2}{90x0.7x0.5} = 0.42A$$

◆ 假设Np使用 0.32 ¥ 的线

电流密度=
$$\frac{0.42}{3.14x \left(\frac{0.32}{2}\right)^2} = \frac{0.42}{3.14x 0.1024} = 1.286A$$

可绕圈数=
$$\frac{$$
剩餘可繞面績 $=\frac{4.4}{(0.32+0.03)}=12.57$ 圈

◆ 假设 Secondary 使用 0.35 ¥ 的线

电流密度=
$$\frac{4}{3.14x\left(\frac{0.35}{2}\right)^2} = \frac{4}{3.14x0.0289} = 44.07A$$

◆ 假设使用 4P,则

电流密度=
$$\frac{44.07}{4}$$
=11.02A

可绕圈数=
$$\frac{4.4}{(0.35+0.03)}$$
=11.57圏

● 决定 Duty cycle:

$$\frac{Ns}{Np} = \frac{(Vo + V_D)(1 - D)}{Vin(\min)D}$$

$$\frac{2}{44} = \frac{(3.3 + 0.5)(1 - D)}{90D} \implies D = 48.2\%$$

● 决定 Ip 值:

$$Ip = Iav + \frac{1}{2}\Delta I$$

$$Iav = \frac{Pout}{Vin(\min)x\eta xD} = \frac{13.2}{90x0.7x0.482} = 0.435A$$

$$\Delta I = \frac{Vin(\min)}{Lp} x \frac{D}{f} = \frac{90}{1600u} x \frac{0.482}{45K} = 0.603A$$

$$Ip = 0.435 + \frac{0.603}{2} = 0.737A$$

● 决定辅助电源的圈数:

假设辅助电源=12V

$$\frac{Ns}{N_{Al}} = \frac{3.8}{12}$$
 $\frac{2}{N_{Al}} = \frac{3.8}{12}$ $N_{Al} = 6.3$

假设使用 0.23 ¥ 的线

可绕圈数=
$$\frac{4.4}{(0.23+0.02)}$$
=19.13圏

若NA1=6Tx2P,则辅助电源=11.4V

● 决定 MOSFET 及二次侧二极管的 Stress(应力):

MOSFET(Q1) =最高输入电压(380V)+
$$\frac{Np}{Ns}$$
($Vo+V_D$)
$$=380+\frac{44}{2}(3.3+0.5)$$

$$=463.6V$$

Diode(D5)=输出电压(Vo)+
$$\frac{Ns}{Np}$$
 x 最高输入电压(380V)

$$=3.3+\frac{2}{44}x380$$

=20.57V

$$Diode(D4)= 輸出電壓(N_{A2}) + \frac{Ns}{Np} x$$
最高輸入電壓(380V)

$$=6.6 + \frac{4}{44} \times 380 = 41.4 \text{V}$$

● 其它:

因为输出为 3.3V,而 TL431 的 Vref 值为 2.5V,若再加上 photo coupler 上的压降约 1.2V,将使得输出电压无法推动 Photo coupler 及 TL431,所以必须另外增加一组线 圈提供回授路径所需的电压。

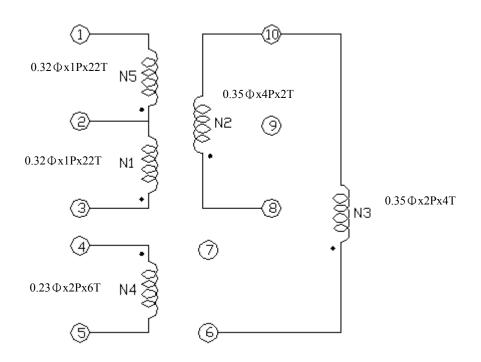
假设 N_{A2} =4T使用 0.35 Ψ 线,则

可绕圈数=
$$\frac{4.4}{(0.35+0.03)}$$
=11.58 T ,所以可将 N_{A2} 定为4 $Tx2P$

$$\frac{Ns}{N_{A2}} = \frac{3.8}{V_{A2}}$$
 $\frac{2}{4} = \frac{3.8}{V_{A2}}$ $\Rightarrow V_{A2} = 7.6V$

•
$$B(\text{max}) = \frac{LpxIp}{NpxAe}x100$$
 $(Gauss) = \frac{1600x0.737}{44x0.86}x100 = 3116.3 Gauss$

● 变压器的接线图:



3.3 零件选用:

零件位置(标注)请参考线路图: (DA-14B33 Schematic)

3.3.1 FS1:

由变压器计算得到 Iin 值,以此 Iin 值(0.42A)可知使用公司共享料 2A/250V,设计时亦须考虑 Pin(max)时的 Iin 是否会超过保险丝的额定值。

3.3.2 TR1(热敏电阻):

电源激活的瞬间,由于 C1(一次侧滤波电容)短路,导致 Iin 电流很大,虽然时间很短暂,但亦可能对 Power 产生伤害,所以必须在滤波电容之前加装一个热敏电阻,以限制开机瞬间 Iin 在 Spec 之内(115V/30A,230V/60A),但因热敏电阻亦会消耗功率,所以不可放太大的阻值(否则会影响效率),一般使用 SCK053(3A/5Ω),若 C1 电容使用较大的值,则必须考虑将热敏电阻的阻值变大(一般使用在大瓦数的 Power 上)。

3.3.3 VDR1(突波吸收器):

当雷极发生时,可能会损坏零件,进而影响 Power 的正常动作,所以必须在靠 AC 输入端 (Fuse 之后),加上突波吸收器来保护 Power(一般常用 07D471K),但若有价格上的考量,可先忽略不装。

3.3.4 CY1, CY2(Y-Cap):

Y-Cap 一般可分为 Y1 及 Y2 电容,若 AC Input 有 FG(3 Pin)一般使用 Y2- Cap , AC Input 若为 2Pin(只有 L, N)一般使用 Y1-Cap, Y1 与 Y2 的差异,除了价格外(Y1 较昂贵),绝缘等级及耐压亦不同(Y1 称为双 重绝缘,绝缘耐压约为 Y2 的两倍,且在电容的本体上会有"回"符号或注明 Y1),此电路因为有 FG 所以使用 Y2-Cap, Y-Cap 会影响 EMI 特性,一般而言越大越好,但须考虑漏电及价格问题,漏电(Leakage Current)必须符合安规须求(3Pin 公司标准为 750uA max)。

3.3.5 CX1(X-Cap), RX1:

X-Cap 为防制 EMI 零件, EMI 可分为 Conduction 及 Radiation 两部分, Conduction 规范一般可分为: FCC Part 15J Class B 、 CISPR 22(EN55022) Class B 两种 , FCC 测试频率在 450K~30MHz,CISPR 22 测试频率

在 150K~30MHz, Conduction 可在厂内以频谱分析仪验证,Radiation 则必须到实验室验证,X-Cap 一般对低频段(150K~数 M 之间)的 EMI 防制有效,一般而言 X-Cap 愈大,EMI 防制效果愈好(但价格愈高),若 X-Cap 在 0.22uf 以上(包含 0.22uf),安规规定必须要有泄放电阻(RX1,一般为 1.2M Ω 1/4W)。

3.3.6 LF1(Common Choke):

EMI 防制零件,主要影响 Conduction 的中、低频段,设计时必须同时考虑 EMI 特性及温升,以同样尺寸的 Common Choke 而言,线圈数愈多(相对的线径愈细),EMI 防制效果愈好,但温升可能较高。

3.3.7 BD1(整流二极管):

将 AC 电源以全波整流的方式转换为 DC,由变压器所计算出的 lin 值,可知只要使用 1A/600V 的整流二极管,因为是全波整流所以耐压只要 600V 即可。

3.3.8 C1(滤波电容):

由 C1 的大小(电容值)可决定变压器计算中的 Vin(min)值,电容量愈大,Vin(min)愈高但价格亦愈高,此部分可在电路中实际验证 Vin(min)是否正确,若 AC Input 范围在 90V~132V (Vc1 电压最高约 190V),可使用耐压 200V 的电容;若 AC Input 范围在 90V~264V(或 180V~264V),因 Vc1 电压最高约 380V,所以必须使用耐压 400V 的电容。

3.3.9 D2(辅助电源二极管):

整流二极管,一般常用 FR105(1A/600V)或 BYT42M(1A/1000V),两者主要差异:

- 1. 耐压不同(在此处使用差异无所谓)
- 2. V_F不同(FR105=1.2V, BYT42M=1.4V)
- 3.3.10 R10(辅助电源电阻):

主要用于调整 PWM IC 的 VCC 电压,以目前使用的 3843 而言,设计时 VCC 必须大于 8.4V(Min. Load 时),但为考虑输出短路的情况,VCC 电压不可设计的太高,以免当输出短路时不保护(或输入瓦数过大)。

3.3.11 C7(滤波电容):

辅助电源的滤波电容,提供 PWM IC 较稳定的直流电压,一般使用 100uf/25V 电容。

3.3.12 Z1(Zener 二极管):

当回授失效时的保护电路,回授失效时输出电压冲高,辅助电源电压相对提高,此时若没有保护电路,可能会造成零件损坏,若在 3843 VCC与 3843 Pin3 脚之间加一个Zener Diode,当回授失效时Zener Diode会崩溃,使得Pin3 脚提前到达 1V,以此可限制输出电压,达到保护零件的目的.Z1 值的大小取决于辅助电源的高低,Z1 的决定亦须考虑是否超过Q1 的V_{GS}耐压值,原则上使用公司的现有料(一般使用 1/2W即可).

3.3.13 R2(激活电阻):

提供 3843 第一次激活的路径,第一次激活时透过 R2 对 C7 充电,以提供 3843 VCC 所需的电压,R2 阻 值较大时,turn on 的时间较长,但短路时 Pin 瓦数较小,R2 阻值较小时,turn on 的时间较短,短路时 Pin 瓦数较大,一般使用 220KΩ/2W M.O。.

3.3.14 R4 (Line Compensation):

高、低压补偿用,使 3843 Pin3 脚在 90V/47Hz 及 264V/63Hz 接近一致(一般使用 750K Ω ~1.5M Ω 1/4W 之间)。

3.3.15 R3, C6, D1 (Snubber):

此三个零件组成 Snubber, 调整 Snubber 的目的:1.当 Q1 off 瞬间会有 Spike 产生, 调整 Snubber 可以确保

Spike 不会超过 Q1 的耐压值, 2.调整 Snubber 可改善 EMI.一般而言, D1 使用 1N4007(1A/1000V)EMI 特性会较好.R3 使用 2W M.O.电阻, C6 的耐压值以两端实际压差为准(一般使用耐压 500V 的陶质电容)。

3.3.16 Q1(N-MOS):

目前常使用的为 3A/600V及 6A/600V两种,6A/600V的 $R_{DS(ON)}$ 较 3A/600V小,所以温升会较低,若 I_{DS} 电流未超过 3A,应该先以 3A/600V为考量,并以温升记录来验证,因为 6A/600V的价格高于 3A/600V许多,Q1 的使用亦需考虑 V_{DS} 是否超过额定值。

3.3.17 R8:

R8 的作用在保护 Q1, 避免 Q1 呈现浮接状态。

3.3.18 R7(Rs 电阻):

3843 Pin3 脚电压最高为 1V, R7 的大小须与 R4 配合,以达到高低压平衡的目的,一般使用 2W M.O.电阻,设计时先决定 R7 后再加上 R4 补偿,一般将 3843 Pin3 脚电压设计在 0.85V~0.95V 之间(视瓦数而定,若瓦数较小则不能太接近 1V,以免因零件误差而顶到 1V)。

3.3.19 R5, C3(RC filter):

滤除 3843 Pin3 脚的噪声,R5 一般使用 $1K\Omega$ 1/8W,C3 一般使用 102P/50V 的陶质电容,C3 若使用电容值较小者,重载可能不开机(因为 3843 Pin3 瞬间项到 1V);若使用电容值较大者,也许会有轻载不开机及短路 Pin 过大的问题。

3.3.20 R9(Q1 Gate 电阻):

R9 电阻的大小,会影响到 EMI 及温升特性,一般而言阻值大,Q1 turn on / turn off 的速度较慢,EMI 特性较好,但 Q1 的温升较高、效率较低(主要是因为 turn off 速度较慢);若阻值较小, Q1 turn on / turn off 的速度较快,Q1 温升较低、效率较高,但 EMI 较差,一般使用 51Ω - 150Ω 1/8W。

3.3.21 R6, C4(控制振荡频率):

决定 3843 的工作频率,可由 Data Sheet 得到 R、C 组成的工作频率, C4 一般为 10nf 的电容(误差为 5%), R6 使用精密电阻,以 DA-14B33 为例, C4 使用 103P/50V PE 电容, R6 为 3.74KΩ 1/8W 精密电阻,振荡 频率约为 45 KHz。

3.3.22 C5:

功能类似 RC filter, 主要功用在于使高压轻载较不易振荡,一般使用 101P/50V 陶质电容。

3.3.23 U1(PWM IC):

3843 是PWM IC的一种,由Photo Coupler (U2)回授信号控制Duty Cycle的大小,Pin3 脚具有限流的作用(最高电压 1V),目前所用的 3843 中,有KA3843(SAMSUNG)及UC3843BN(S.T.)两种,两者脚位相同,但产生的振荡频率略有差异,UC3843BN较KA3843 快了约 2KHz,f_T的增加会衍生出一些问题(例如:EMI问题、短路问题),因KA3843 较难买,所以新机种设计时,尽量使用UC3843BN。

3.3.24 R1、R11、R12、C2(一次侧回路增益控制):

3843 内部有一个 Error AMP(误差放大器), R1、R11、R12、C2 及 Error AMP 组成一个负回授电路, 用来调整回路增益的稳定度, 回路增益, 调整不恰当可能会造成振荡或输出电压不正确, 一般 C2 使用立式积层电容(温度持性较好)。

3.3.25 U2(Photo coupler)

光耦合器(Photo coupler)主要将二次侧的信号转换到一次侧(以电流的方式),当二次侧的 TL431 导通后,U2 即会将二次侧的电流依比例转换到一次侧,此时 3843 由 Pin6 (output)输出 off 的信号(Low)来关闭 Q1,使用 Photo coupler 的原因,是为了符合安规需求(primacy to secondary 的距离至少需 5.6mm)。

3.3.26 R13(二次侧回路增益控制):

控制流过 Photo coupler 的电流,R13 阻值较小时,流过 Photo coupler 的电流较大,U2 转换电流较大,回路增益较快(需要确认是否会造成振荡),R13 阻值较大时,流过 Photo coupler 的电流较小,U2 转换电流较小,回路增益较慢,虽然较不易造成振荡,但需注意输出电压是否正常。

3.3.27 U3(TL431), R15, R16, R18

调整输出电压的大小, $Vo = Vref \ x \ \frac{(R13//R16) + R18}{(R15//R16)}$,输出电压不可超过 38V(因为TL431 V_{KA} 最

大为 36V,若再加Photo coupler的 V_F 值,则 V_F 0应在 38V以下较安全), T_F 1.431 的 V_F 1 的 V_F 2.5 V_F 1.5 V_F 1.5 V_F 1.5 V_F 1.6 V_F 1.5 V_F 1.6 $V_$

3.3.28 R14, C9(二次侧回路增益控制):

控制二次侧的回路增益,一般而言将电容放大会使增益变慢;电容放小会使增益变快,电阻的特性则刚好与电容相反,电阻放大增益变快;电阻放小增益变慢,至于何谓增益调整的最佳值,则可以 Dynamic load 来量测,即可取得一个最佳值。

3.3.29 D4(整流二极管):

因为输出电压为 3.3V, 而输出电压调整器(Output Voltage Regulator)使用 TL431(Vref=2.5V)而非 TL432(Vref=1.25V), 所以必须多增加一组绕组提供 Photo coupler 及 TL431 所需的电源, 因为 U2 及 U3 所需的电流不大(约 10mA 左右), 二极管耐压值 100V 即可, 所以只需使用 1N4148(0.15A/100V)。

3.3.30 C8(滤波电容):

因为 U2 及 U3 所需的电流不大, 所以只要使用 1u/50V 即可。

3.3.31 D5(整流二极管):

输出整流二极管, D5 的使用需考虑:

- a. 电流值
- b. 二极管的耐压值

以DA-14B33 为例,输出电流 4A,使用 10A的二极管(Schottky)应该可以,但经点温升验证后发现D5 温度偏高,所以必须换为 15A的二极管,因为 10A的 V_F 较 15A的 V_F 值大。耐压部分 40V经验证后符合,因此最后使用 15A/40V Schottky。

3.3.32 C10, R17(二次侧 snubber):

D5 在截止的瞬间会有 spike 产生,若 spike 超过二极管(D5)的耐压值,二极管会有被击穿的危险,调整 snubber 可适当的减少 spike 的电压值,除保护二极管外亦可改善 EMI,R17 一般使用 1/2W 的电阻,C10

一般使用耐压 500V 的陶质电容, snubber 调整的过程(264V/63Hz)需注意 R17,C10 是否会过热, 应避免此种情况发生。

3.3.33 C11, C13(滤波电容):

二次侧第一级滤波电容,应使用内阻较小的电容(LXZ,YXA...),电容选择是否洽当可依以下三点来判定:

- a. 输出 Ripple 电压是符合规格
- b. 电容温度是否超过额定值
- c. 电容值两端电压是否超过额定值

3.3.34 R19(假负载):

适当的使用假负载可使线路更稳定,但假负载的阻值不可太小,否则会影响效率,使用时亦须注意是否超过电阻的额定值(一般设计只使用额定瓦数的一半)。

3.3.35 L3, C12(LC 滤波电路):

LC 滤波电路为第二级滤波,在不影响线路稳定的情况下,一般会将 L3 放大(电感量较大),如此 C12 可使用较小的电容值。

4 设计验证:(可分为三部分)

- a. 设计阶段验证
- b. 样品制作验证
- c. OE 验证

4.1 设计阶段验证

设计实验阶段应该养成记录的习惯,记录可以验证实验结果是否与电气规格相符,以下即就 DA-14B33 设计阶段验证做说明(验证项目视规格而定)。

4.1.1 电气规格验证:

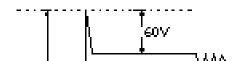
4.1.1.1 3843 PIN3 脚电压(full load 4A):

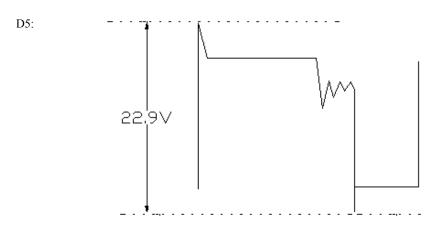
90V/47Hz = 0.83V 115V/60Hz = 0.83V 132V/60Hz = 0.83V 180V/60Hz = 0.86V 230V/60Hz = 0.88V 264V/63Hz = 0.91V

4.1.1.2 Duty Cycle, f_T:

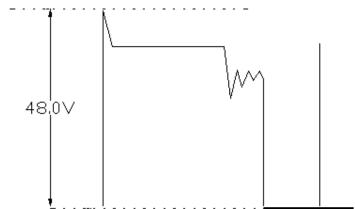
- 4.1.1.3 Vin(min) = 100V (90V / 47Hz full load)
- 4.1.1.4 Stress (264V / 63Hz full load):

Q1 MOSFET:





D4:



$$90V/47Hz$$

開機 = $0.18A(8.4V)$
滿載 = $11.26V(4A)$
短路 = $1.2W(\text{max.})$
 $264V/63Hz$
開機 = $0.13A(8.4V)$
滿載 = $11.26V(4A)$
短路 = $8.8W(\text{max.})$

4.1.1.6 Static (full load)

	Pin(w)	Iin(A)	Iout(A)	Vout(V)	P.F.	Ripple(mV)	Pout(w)	eff
90V/47Hz	18.7	0.36	4	3.30	0.57	32	13.22	70.7
115V/60Hz	18.6	031	4	3.30	0.52	28	13.22	71.1
132V/60Hz	18.6	0.28	4	3.30	0.50	29	13.22	71.1
180V/60Hz	18.7	0.21	4	3.30	0.49	30	13.23	70.7

230V/60Hz	18.9	0.18	4	3.30	0.46	29	13.22	69.9
264V/60Hz	19.2	0.16	4	3.30	0.45	29	13.23	68.9

4.1.1.7 Full Range 负载(0.3A-4A)

(验证是否有振荡现象)

 $\begin{cases} 90V/47Hz &= OK \\ 115V/60Hz &= OK \\ 132V/60Hz &= OK \\ 180V/60Hz &= OK \\ 230V/60Hz &= OK \\ 264V/63Hz &= OK \end{cases}$

4.1.1.8 回授失效(输出轻载)

 $90V/47Hz \square Vout = 8.3V$

 $264V/63Hz \square Vout = 6.03V$

4.1.1.9 O.C.P.(过电流保护)

90V/47Hz = 7.2A

264V/63Hz = 8.4A

4.1.1.10 Pin(max.)

90V/47Hz = 24.9W

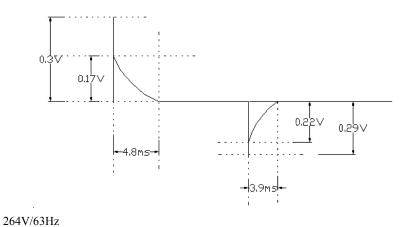
264V/63Hz = 27.1W

4.1.1.11 Dynamic test

H=4A, t1=25ms, slew Rate = 0.8A/ms (Rise)

L=0.3A, t2=25ms, slew Rate = 0.8A/ms (Full)

90V/47Hz



0.3V 0.15V 0.23V 0.29V -4.3ms-

4.1.1.12 HI-POT test:

HI-POT test 一般可分为两种等级:

- ▶ 输入为 3 Pin(有 FG 者), HI-POT test 为 1500Vac/1 minute。Y-CAP 使用 Y2-CAP
- ➤ 输入为 2 Pin(无 FG 者), HI-POT test 为 3000Vac/1 minute。Y-CAP 使用 Y1-CAP DA-14B33 属于输入 3 PIN HI-POT test 为 1500Vac/1 minute。

4.1.1.13 Grounding test:

输入为 3 Pin(f FG d), 一般均要测接地阻(Grounding test), 安规规定 FG 到输出线材(输出端)的接地电阻不能超过 $100 \text{m} \Omega (25 \text{A}/3 \text{ Second})$ 。

4.1.1.14 温升记录

设计实验定案后(暂定),需针对整体温升及 EMI 做评估,若温升或 EMI 无法符合规格,则需重新实验。温升记录请参考附件,D5 原来使用 BYV118(10A/40V Schottky),因温升较高改为 PBYR1540CTX(15A/40V)。

4.1.1.15 EMI 测试:

EMI 测试分为二类:

- ➤ Conduction(传导干扰)
- ➤ Radiation(幅射干扰)

前者视规范不同而有差异(FCC: 450K - 30MHz, CISPR 22:150K - 30MHz), 前者可利用厂内的频谱分析仪验证;后者(范围由 30M - 300MHz,则因厂内无设备必须到实验室验证, Conduction, Radiation测试数据请参考附件)。

4.1.1.16 机构尺寸:

设计阶段即应对机构尺寸验证,验证的项目包括:PCB尺寸、零件限高、零件禁置区、螺丝孔位置及孔径、外壳孔寸....,若设计阶段无法验证,则必须在样品阶段验证。

4.1.2 样品验证:

样品制作完成后,除温升记录、EMI测试外(是否需重新验证,视情况而定),每一台样品都应经过验证(包括电气及机构尺寸),此阶段的电气验证可以以ATE(Chroma)测试来完成,ATE测试必须与电气规格相符。

4.1.3 QE 验证:

QE 针对工程部所提供的样品做验证,工程部应提供以下交件及样品供 QE 验证。

